

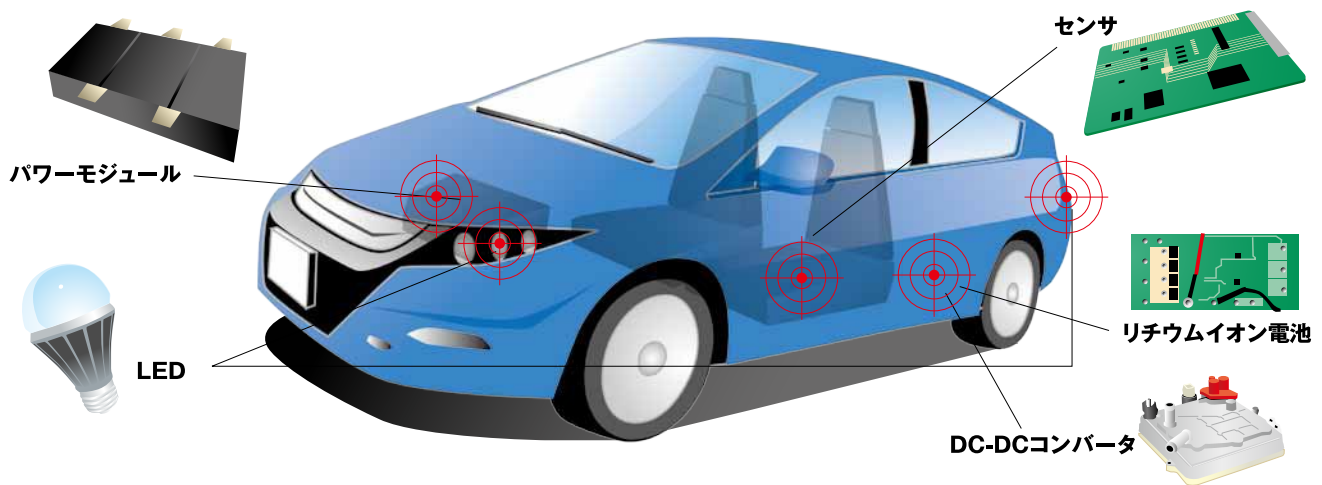
車載用ECU、パワーモジュール、LEDなどの用途に最適

Ideal for automotive ECUs, power modules, LEDs, and other applications

特長

- 耐温度サイクル特性が要求される基板実装に適する。
- 車載電子制御機器、パワーモジュール、産業機器、LEDインバータ基板等。

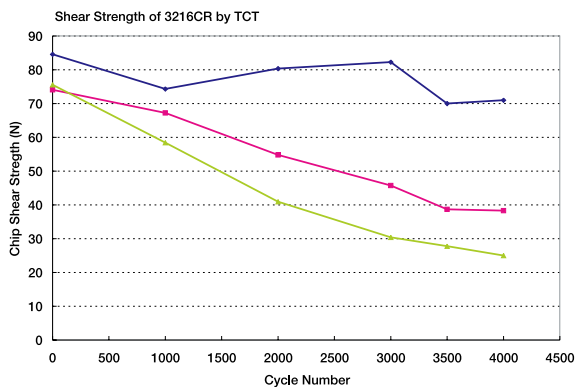
用途



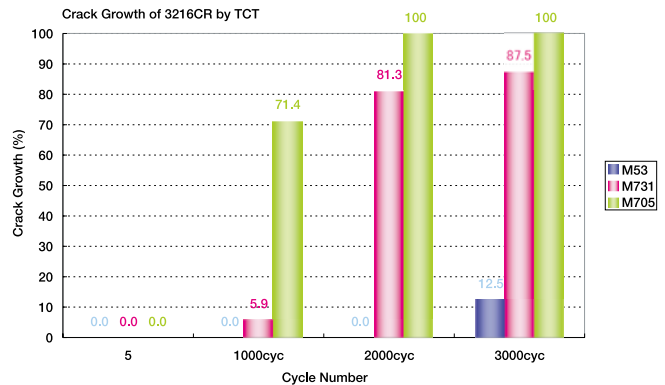
製品仕様

- **温度サイクル特性 (3216チップ抵抗)** ■条件: -40/+125°C 各30分保持 ■部材: 3216チップ抵抗 (Snめっき) / FR-4 (6層基板)

(a) 温度サイクルによる接続強度推移



(b) 温度サイクルによるクラック発生率
クラック判定: チップ下電極までの貫通



□ **製品ラインナップ**

品名	組成	融点 (°C)	備考
M705	Sn-3.0Ag-0.5Cu	217-220	Pbフリー標準
M53	Sn-3.0Ag-Bi-In	198-214	Sbフリー高信頼性はんだ開発合金
M731	Sn-3.9Ag-0.6Cu-3.0Sb	220-225	パワーモジュール等で市場実績有り